

T4AB58-HF360 (Sn 0.4Ag 57.6Bi) Type 4

## 低温はんだ合金溶剤ペースト (Bi系)

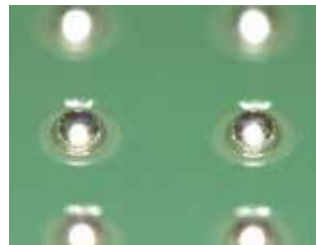
低融点合金

低ボイド

ハロゲンフリー

低温域リフローで信頼性・作業性を両立

- 低温プロファイル化で、耐熱保証温度の低い電子デバイス実装時の熱破壊を防止
- PET 基板、紙フェノール基板 (FR-1)、紙 / コンポジット (CEM3) など、ローコスト基板での実装が可能
- SAC 系合金と比較して、はんだの濡れ広がりに優れ、低ボイド接合を実現



S5A48-M500C (Sn 5.0Sb) Type 3

## 高温はんだ合金溶剤ペースト (Sb系)

高融点合金

高濡れ

低ボイド

SAC305よりも高い融点でのリフロー接合が可能

- 融点が 238 - 241°C の高融点はんだ
- 0.3mmφ及び 0603 チップ部品で良好な濡れ性
- 新規添加材の使用で、部品電極下部のボイド発生を抑制

